

证券代码：688603

证券简称：天承科技

# 广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	通过上证路演中心参与“2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会”的投资者 通过“全景路演”参与“2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动的投资者
调研时间	2024年9月12日（周四）14:00-16:00 2024年9月12日（周四）15:30-16:30
会议地点	上证路演中心（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ） “全景路演”网站（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 副总经理、董事会秘书：费维 财务总监：王晓花 独立董事：杨振国
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问公司上半年PCB电镀添加剂产品的发展情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，PCB电镀添加剂作为公司高毛利产品，其技术壁垒较高，公司经过多年的自主研发和下游应用累积了丰富经验，相关产品覆盖下游PCB行业全部电镀线类型。2024年上半年，公司的溶铜块VCP不溶性阳极脉冲电镀在客户端成功上线，推动了行业技术发展，公司也正积极向对应新客户推广。感谢您的关注！</p> <p>（二）请问公司下半年的订单和销售情况？半导体先进封装领域是否</p>

**已开始贡献营收？**

答复：

尊敬的投资者您好，截至目前，公司下半年的订单量和销售量较上半年有明显上涨。公司半导体先进封装领域中的 TGV 电镀添加剂已向部分客户小批量销售，现正把握行业时机积极推广中。感谢您的关注！

**（三）请问董秘，上半年水平沉铜新增多少条产线？下半年公司整体业绩指引如何？**

答复：

尊敬的投资者您好，公司 2024 年上半年新增了 10 条左右水平沉铜下游产线。公司下半年将继续以沉铜、电镀等电子电路核心制程所需产品为重点和导向，不断丰富产品种类，持续拓宽产品于下游客户的应用规模，以及加速推广先进封装领域产品的拓展，形成公司业绩新的增长点。感谢您的关注！

**（四）请问公司最近东南亚拓展情况如何？**

答复：

尊敬的投资者您好，公司前期已与下半年将在泰国、马来西亚等地区投产的部分客户进行了充分沟通与接触，相关的前期技术支持、解决方案提供等工作在陆续进行完毕，公司将在前述客户开线投产时向其提供产品及配套技术服务。公司对外投资备案已获批，现正在进行东南亚子公司的产能布局建设。感谢你的关注！

**（五）请问公司的上海集成电路添加剂项目工厂进展如何？**

答复：

尊敬的投资者您好，上海二期项目工厂已启动试生产工作并具备大批量供货能力。公司先进封装相关电镀产品目前在头部封测客户等多处下游验证中，目前获得的测试结果都较好，符合客户的预期。感谢您的关注！

**（六）请问公司 24 年上半年净利润较上年明显增加的原因是什么？**

答复：

尊敬的投资者您好，得益于下游电子电路行业景气度回升与公司

	新客户及下游电镀线的拓展，公司 24 年上半年的订单量和销售量同比都有不错的增长水平。净利润增加主要有两个原因：（1）公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升；（2）公司募集资金理财收益及银行存款利息收入的增加。感谢您的关注！
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 12 日